

中信建投证券股份有限公司
关于美芯晟科技（北京）股份有限公司
2024 年持续督导年度报告书

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	上市公司名称：美芯晟科技（北京）股份有限公司
保荐代表人姓名：曾宏耀	联系方式：010-56051415 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层
保荐代表人姓名：董军峰	联系方式：021-68801585 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕521 号文”批准，同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（简称“公司”或“美芯晟”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）20,010,000 股，每股面值 1 元。本次公司发行新股的发行价为 75.00 元/股，募集资金总额为 150,075.00 万元，扣除发行费用 12,426.69 万元后，实际募集资金净额为 137,648.31 万元。本次公开发行股票于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作，出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与公司签订持续督导协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对公司开展了持续督

	工作内容	持续督导情况
		导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	本持续督导期间，公司未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	本持续督导期间，公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	本持续督导期间，保荐机构已督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事和高级管理人员的行为规范等。	本持续督导期间，保荐机构已督导公司依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	本持续督导期间，保荐机构对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	本持续督导期间，保荐机构已督导公司严格执行信息披露制度，并审阅其向上海证券交易所提交的信息披露文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。对上市公司的信息披露文件未进行事	本持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。

	工作内容	持续督导情况
	前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未出现该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，公司及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，经保荐机构核查，公司不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	本持续督导期间，公司未出现该等事项。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确了具体的检查工作要求。本持续督导期间，公司未出现该等需开展专项现场检查的事项。

	工作内容	持续督导情况
	检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	本持续督导期间，公司不存在未履行承诺的情况。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现美芯晟科技（北京）股份有限公司存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

报告期内，整体宏观经济和半导体行业回暖不及预期，市场竞争加剧，公司持续技术创新加大研发投入，导致公司归属于上市公司股东的净利润同比下降并出现亏损。为保证公司的可持续发展、高质量发展及产业布局完善，预计公司将保持较高的研发投入水平。如果后期下游终端市场需求持续下降、市场竞争加剧、宏观景气度下行、国家产业政策变化，或者公司新品放量未达预期，将对公司经营业绩产生较大不利影响。

（二）核心竞争力风险

1、产品迭代及技术创新风险

集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快，持续研发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。目前，行业内企业主要根据市场需求变动和工艺水平发展对现有技术进行升级迭代，以保持产品竞争力。未来，如果公司不能及时准确地把握市场需求和技术趋势、突破技术难关，无法研发出具有商业价值、符合市场需求的新产品，可能会对公司竞争能力和持续盈利能力产生不利影响。

2、高端人才流失风险

集成电路设计行业属于智力和技术密集型产业，高端、专业人才是公司综合竞争力的体现和未来持续发展的基础。经过多年发展和培养，我国已拥有了大批集成电路设计行业从业人员，但与国际顶尖集成电路设计企业比，高端、专业人才仍然可贵难求。目前，公司已针对优秀人才提供了丰厚的薪酬及激励措施，但随着行业竞争日益激烈，同行业公司仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或公司受其他因素影响导致公司存在技术人员流失的风险。如果未来公司的专业人才不能及时引进或既有人才团队出现流失，可能会对公司经营产生不利影响。

3、核心技术泄密风险

公司凭借多年技术创新，积累了一系列自主研发的核心技术，核心技术覆盖产品研发、生产等生命周期，形成公司核心竞争力。报告期内，公司仍有多项产品处于研发阶段，即公司在持续不断探索并形成核心技术。公司对核心技术采取了严格的保密措施，包括但不限于与技术所涉主体签署保密协议、为技术申请各类产权保护等，以确保核心技术安全保密。尽管如此，未来如果因员工个人疏忽、工作失误或外部恶意窃取，导致公司核心技术外泄，可能会对公司核心竞争力产生不利影响，进而影响公司经营成果及业绩。

（三）经营风险

1、大额研发投入风险

集成电路行业是资本密集型行业，技术迭代升级周期短，研发投入成本高。为保证产品的先进性，集成电路设计公司必须持续进行大量研发投入，通过不断的创新尝试并耗费一定的试错成本才能获得研发上的攻坚成果，因此大量研发资金需求形成了行业壁垒。随着市场需求不断迭代更新、产品制造工艺持续升级，若公司不能持续进行资金投入，或者在研发方向上未能正确做出判断，在研发过程中关键技术未能突破、产品性能指标未达预期，或者开发的产品不能契合市场需求，公司将面临研发失败的风险，前期的研发投入将难以收回，且会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。

2、经营规模扩大带来的管理风险

随着公司业务的迅速发展和规模的不断扩大，公司在外部市场扩张、产业链资源整合、产品质量管控、内部组织架构调整等方面将面临一定的挑战。公司将持续建设管理体系、优化内外部信息流沟通渠道、提高管理决策效率，以确保对

前述挑战快速响应并形成稳健优秀的应对能力。未来，如果公司的管理方式、管理能力及效率无法快速匹配业务规模的持续扩张，可能会对公司的管理情况及经营业绩产生不利影响。

（四）财务风险

1、毛利率波动风险

公司产品毛利率水平主要受半导体行业发展、市场供求关系、技术先进性、产品结构、产品更新迭代、市场销售策略等因素综合影响。未来，如果半导体行业竞争进一步加剧、市场行情有较大波动，或公司无法保持技术先进性、无法通过持续研发完成产品的更新换代致使产品市场竞争力下降，或公司产品结构发生重大变化，导致综合毛利率下降，可能会对公司的经营成果及盈利能力产生影响。

2、存货跌价风险

随着公司业务规模的不断扩大，存货规模随之上升。未来，如果市场竞争加剧、市场需求有所变化，或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模，将会导致存货积压，从而提高存货跌价风险，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

3、汇率波动风险

报告期内，公司存在境外销售和采购以外币报价和结算的情况，尽管公司在开展业务时已经对合同签订和款项结算过程中可能遇到的汇率波动因素进行了审慎考量，但鉴于国际政治和经济环境的不断变化，汇率的波动性仍然存在。因此，如果未来人民币与外币之间的汇率发生较大波动，可能会对公司的财务表现产生一定程度的影响。

（五）行业风险

公司专注于高性能模拟及数模混合芯片的研发，属于集成电路产业。集成电路产业是高度资本和技术集中的领域，行业的发展一方面依赖于业内企业研发技术的进步来持续推动，另一方面也与宏观经济环境紧密相连。近年来，随着产品技术快速发展，下游行业及领域的市场需求变化明显，终端客户产品更新换代加速。未来，如果宏观经济环境出现较大不确定性，将传导影响至公司所处的集成电路行业，可能会导致行业复苏放缓；如果下游应用领域所处的行业受到其自身的周期性影响或者冲击，将可能导致该领域对芯片产品的需求缩减，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（六）宏观环境风险

集成电路行业受国内外经济形势、地缘政治及国际贸易等宏观环境因素的影响较大。一方面，地缘政治紧张局势的加剧增强了全球经济的不确定性。另一方面，国际市场的贸易限制对集成电路行业的供应链有所冲击，导致行业市场竞争加剧，整体复苏仍旧需要一定时间。未来，如果全球地缘政治环境及国际贸易摩擦不确定性有所加剧，可能会对集成电路行业的整体复苏产生不利影响，导致产业链上游供给受限及下游需求不足，进而影响公司的经营业绩。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，美芯晟科技（北京）股份有限公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	404,167,862.57	472,306,007.71	-14.43
归属于上市公司股东的净利润	-66,567,127.54	30,153,546.93	-320.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-93,082,044.96	6,168,347.73	-1,609.03
经营活动产生的现金流量净额	-77,081,101.61	-152,616,815.94	不适用
主要会计数据	2024 年 12 月末	2023 年 12 月末	本期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,889,097,759.39	2,082,058,775.70	-9.27
总资产	1,996,913,482.37	2,155,707,764.30	-7.37

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	-0.61	0.30	-303.33
稀释每股收益（元/股）	-0.61	0.30	-303.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.85	0.06	-1,516.67
加权平均净资产收益	-3.36	2.02	减少 5.38 个百分点

主要财务指标	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	本期比上年同期增减 (%)
率 (%)			
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收 益率 (%)	-4.70	0.41	减少 5.11 个百分点
研发投入占营业收入 的比例 (%)	40.60	21.75	增加 18.85 个百分点

2024 年，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、报告期内公司营业收入同比下降 14.43%，主要为模拟电源管理芯片终端电子消费市场阶段性低迷，产品售价有一定程度下降；同时，无线充电部分终端客户产品节奏调整，导致该板块的收入在报告期内有阶段性回落所致。

2、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为-6,656.71 万元，较上年同期的盈利 3,015.35 万元，减少 9,672.07 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,308.20 万元，较上年同期的盈利 616.83 万元，减少 9,925.04 万元。主要受以下因素影响：市场需求端，随着竞争日益充分，国内半导体行业从高速发展逐步过渡到高质运营，下游客户优化成本，导致公司 2024 年成本压力较大，毛利率收窄；研发投入侧，公司为满足高端市场需求，持续加大研发力度，研发费用同比增长 59.73%，其中研发人员薪酬、新产品开发材料、测试实验等费用均大幅增加。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期改善，主要为客户回款增加、经营采购减少所致。

4、归属于上市公司股东的净资产、总资产、基本每股收益、稀释每股收益和扣非后每股收益较上年同期减少，主要为报告期内公司净利润同比下降，回购股份和现金分红导致净资产下降所致

六、核心竞争力的变化情况

（一）系统化创新与高集成技术内核双擎驱动，构筑企业技术壁垒

公司基于跨学科及多领域融合的高集成技术内核，通过系统级架构设计持续推动产业升级，在多个细分领域保持领先优势。在光学传感器方向，公司开发的信号链产品作为高度跨学科的集成化系统芯片，深度融合数模混合 SoC 设计、光路设计、封装设计、VCSEL 器件、PD 工艺、镀膜技术及图像处理等核心技术模块，具备完整的自主技术体系：拥有自主 PD/SPAD 工艺、特种镀膜及专

用封装等核心工艺技术，建立了激光领域全链条技术储备与供应链体系；凭借在低噪声信号处理、高精度图像处理等核心领域的专业技术积累与自研光电工艺的协同创新，在灵敏度、精度及动态范围等关键指标取得重大突破，多款产品性能超越国际标杆。

在无线充电领域，公司创造性地推出高功率 RX+4:2 电荷泵双芯片架构，该架构在不改变线圈结构及输出电流能力的前提下，有效提升无线充电的系统效率及可靠性，同时还为无线充电功率达到并且突破 30W 提供了技术上的可能性。在 LED 驱动技术方面，公司不仅首创了单级高功率因数架构与恒流算法，并且开创性提出将 PWM 信号转变为模拟信号从而实现对 LED 光亮进行模拟量调节的方案，引领照明领域架构的创新变革。

（二）“电源管理+信号链”双轮驱动，“手机+汽车+机器人”三大战略平台布局

公司自创立以来实现了从单一产品到多元生态的战略升级：初期以 LED 驱动为代表的纯模拟电源产品奠定模拟电源技术根基，随后突破无线充电等数模混合芯片领域，构建了完整的高压大电流电源管理产品体系，其行业领先的技术实力已获得全球顶级手机品牌认可。2021 年公司将产品战略拓展至模拟芯片的另一个领域-信号链，凭借多学科融合的高集成技术内核和自主工艺平台优势，快速组建专业研发团队，重点开发高集成度光学传感器产品。这一战略转型不仅延续了公司在智能手机领域的客户优势，更通过定制化国产替代解决方案，成功将产品矩阵从电源管理扩展至智能传感领域，实现了核心技术平台的协同效应、客户价值的深度挖掘及市场壁垒的持续强化，展现出强大的技术延展能力和商业洞察力。

与此同时，在“手机+汽车+机器人”三大应用场景快速爆发的产业机遇下，公司正加速战略布局：一方面，蓬勃发展的国内新势力车企不仅带来芯片需求量的指数级增长，更为国产芯片提供了宝贵的替代窗口；另一方面，机器人及 AI 边缘计算设备的普及催生了对高可靠电源管理和智能传感芯片的海量需求。面对汽车电子严苛的可靠性要求（AEC-Q100 认证）与长验证周期，以及消费电子工业级的技术标准，公司充分发挥在手机客户端锤炼的成熟质量体系与量产交付能力，战略性地将业务版图从现有的手机客户平台拓展到汽车客户平台，乃至机器人平台，继续夯实“电源管理+信号链”双驱动产品策略，研发业内领先的技术

产品。

（三）自研工艺开发能力与稳定的供应链合作关系

在工艺技术领域，公司构建了独特的垂直整合优势：作为少数同时掌握自研光学工艺平台与高压 BCD 工艺的芯片设计企业，公司通过专业工艺研发团队持续突破关键技术节点，持续强化自研工艺及特殊器件开发能力，有效降低对标准工艺的依赖。自主开发的 700V-BCD 高压集成工艺、100V-BCD 器件工艺、90nm BCD 工艺、PD/SPAD 光电工艺及专用封装开发工艺，结合创新的全镀膜设计与 VCSEL 器件技术，形成了完整的光电集成解决方案。这一自主工艺体系不仅实现了供应链安全与成本优势，更在器件性能、产品迭代速度等方面建立显著壁垒，为智能传感、车载光学、机器人等新兴应用提供差异化技术支撑。

供应链是保障半导体及集成电路设计公司稳定发展不可或缺的重要环节之一。公司依托自主技术体系和工艺开发平台优势，与国内头部晶圆厂和业内知名封测企业建立深度战略合作，通过产品设计与制造工艺的协同优化，构建了稳定高效的供应链体系。这一创新合作模式既增强了产品市场竞争力，又有效平抑了产能波动风险，为公司可持续发展提供了坚实保障。

（四）战略人才梯队与知识产权优势协同赋能

公司拥有一支由行业顶尖专家领衔的研发团队，核心成员均具备二十年以上国际前沿芯片研发经验，覆盖光学工艺、功率器件、系统架构和固件开发等关键领域。截至报告期末，公司研发团队规模达 180 人，占员工总数的 66.18%，构建了完整的人才梯队。通过“股权激励+薪酬激励+职业发展”三维人才机制，配合完善的培训晋升体系，公司打造了高度稳定、富有创新活力的研发团队，为持续技术创新提供坚实保障。

公司高度重视研发投入，聚焦高电压、大电流、高集成数模混合电源管理和信号链等技术领域与自研工艺领域，公司已构建完善的知识产权护城河。截至报告期末，公司累计申请知识产权 286 项，累计获得知识产权总量达到 178 项，其中国际发明专利授权 3 项，国内发明专利 66 项，实用新型专利 95 项，软件著作权 3 项，集成电路布图设计专有权 11 项。基于完善的知识产权体系，公司在信号链光学传感器芯片、无线充电芯片、模拟电源芯片等核心产品线建立了显著的技术领先优势，并通过持续的研发投入和技术迭代，不断强化市场竞争壁垒，为业务可持续发展提供强劲动力。

（五）全领域应用覆盖与战略客户体系构建

公司依托顶尖研发团队、成熟先进的质量管控体系和深厚的模拟与数模混合芯片技术积累，与行业头部客户构建了深度战略伙伴关系。通过定制化解决方案和联合创新机制，公司实现了从单一产品供应到技术生态共建的合作升级。目前产品已全面渗透通信终端、消费电子、汽车电子、工商业照明、智能家居等成熟市场，并战略性布局工业智控、低空经济和 AIoT 等新兴领域，持续培育业务增长点。

经过多年行业深耕，公司建立了完善的销售网络，与行业知名终端客户形成了稳定的供需协同机制。品牌客户的高度认可不仅验证了产品技术实力，更成为公司市场竞争力的有力背书。为满足客户对产品性能、可靠性和迭代速度的严苛要求，公司持续强化研发体系，包括建立客户需求快速响应机制、完善产品全生命周期管理以及优化供应链协同能力。目前公司已成功导入多家国际品牌供应链系统，并借此构建了更严格的品控标准和更前瞻的产品规划能力。公司将持续深化与战略客户的合作，不断开发高性能、多样化的电源管理芯片及信号链芯片产品，巩固在细分市场的领先地位。

（六）先进的质量管理体系与快速高效的技术支持

公司致力于持续提升研发能力和产品质量，构建了贯穿产品全生命周期的质量管理体系。通过引入国际先进的 PLM 系统，实现了从产品规划、研发设计到量产交付的全流程质量管控。目前，公司正积极推进 ISO26262 功能安全认证，这将进一步提升车规级产品的质量管理标准。在供应链管理方面，公司建立了完善的供应商开发与评估体系，通过良率监控系统和持续改进机制，确保供应链质量水平的稳步提升。

同时，公司不断推进本土化快速响应支持，在全球 10 个分支机构均配置专业团队，从销售、市场应用到质量服务，形成“三位一体”的服务体系。通过将质量控制延伸至客户端，公司建立了从芯片设计到终端应用的全链条质量保障机制，真正实现了以客户为中心，持续提升客户满意度和产品市场竞争力。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

2024 年，公司研发支出变化情况如下：

单位：万元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	16,410.58	10,274.00	59.73%
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	16,410.58	10,274.00	59.73%
研发投入总额占营业收入比例（%）	40.60	21.75	增加 18.85 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

主要系报告期公司高度注重研发人才团队的建设及扩张,加快新产品线拓展并加大新品开发的研发投入,同时增加新产品开发材料、测试实验等费用所致。

（二）研发进展情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司累计获得国际发明专利授权 3 项,获得国内发明专利授权 66 项,实用新型专利 95 项,软件著作权 3 项,集成电路布图设计专有权 11 项。报告期内(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日),公司新增知识产权项目申请 32 项(其中发明专利 17 项),获得新增授权知识产权为 28 项。

报告期内获得的知识产权列表如下:

项目	本年新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	17	11	168	69
实用新型专利	12	14	104	95
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	3	3	3	3
其他	0	0	11	11
合计	32	28	286	178

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

2024 年度,公司募集资金使用情况为:投入募投项目 18,608.97 万元,支付发行费用 34.42 万元,用于股票回购 11,981.20 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 82,036.57 万元,募集资金余额为 71,289.21 万元,明细如下所示:

项目	金额（万元）
募集资金总额	150,075.00
减：已累计投入募集资金总额	82,036.57
其中：上期投入募集资金用于支付发行费用（不含税金额）	12,392.27
本期投入募集资金用于支付发行费用（不含税金额）	34.42
截止本报告期末累计募投项目支出	57,628.68
其中：上期募投项目支出	39,019.71
本期募投项目支出	18,608.97
超募资金经批准用于股票回购	11,981.20
其中：以前年度股票回购	-
本年度股票回购	11,981.20
加：利息收入	586.71
其中：以前年度利息收入	350.91
本年度利息收入	235.81
加：理财收益	2,667.68
其中：以前年度理财收益	1,185.05
本年度理财收益	1,482.63
减：手续费支出	3.61
其中：以前年度手续费支出	0.20
本年度手续费支出	3.41
减：募集资金结项永久补充流动资金	-
募集资金余额	71,289.21
其中：暂时闲置资金进行现金管理投资	52,200.00
其中：结构性存款	52,200.00

注：上表各项加总数与合计数若有差异，系四舍五入造成。

公司 2024 年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 12 月 31 日，美芯晟的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

姓名/名称	类别	直接持股数量（万股）
Leavision Incorporated	控股股东	1,780.50
Auspice Bright Incorporated	控股股东之一致行动人	388.35
珠海横琴博晟芯投资合伙企业（有限合伙）	控股股东之一致行动人	274.47
珠海横琴轩宇投资合伙企业（有限合伙）	控股股东之一致行动人	203.49
程宝洪	实际控制人、董事长、总经理	-
刘柳胜	董事、副总经理	-
彭适辰	董事	-
胡志宇	董事	-
盛建宏	董事（已离任）	-
李艳和	独立董事	-
杨莞平	独立董事	-
陈玲玲	独立董事	-
朱元军	监事会主席、职工代表监事、行政经理	-
赵兴涛	监事（已离任）、无线充电事业部总监	-
邝宁华	监事	-
刘雁	董事会秘书	-
郭越勇	副总经理、核心技术人员	-
钟明	副总经理	-
于龙珍	财务负责人	-
郑洁	监事、供应链主管	-

截至 2024 年 12 月 31 日，美芯晟的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持有的美芯晟股份均不存在质押、冻结及减持情形。

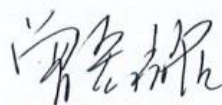
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至 2024 年 12 月 31 日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

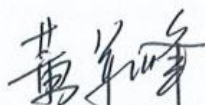
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



曾宏耀



董军峰

